

各位

会社名 新光電気工業株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 豊木 則行  
コード番号 6967 東証第1部  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長  
清野 貴博  
TEL (026) 283-1000 (代)

## 半導体用フリップチップタイプパッケージへの設備投資の増額について

当社は、2018年4月27日付「半導体用フリップチップタイプパッケージの生産体制強化に関するお知らせ」にて、次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化を目的とする設備投資計画（2018～2019年度投資額計 215億円）をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、一層の生産能力増強をはかることを目的とし、本設備投資の増額を決議いたしました。

フリップチップタイプパッケージは、半導体の微細化、高密度化に対応する半導体パッケージとして、大容量のデータを高速で処理するサーバー向けをはじめ、需要拡大が想定されております。当社におきましては、これらのニーズをふまえ、次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化をはかるべく、高丘工場（長野県中野市）等において、順次、設備導入・生産ライン構築を行っております。

今後、IoT、AIの活用の進展や、次世代移動通信規格（5G）の実用化等を背景として、次世代フリップチップタイプパッケージは、高性能半導体向けにさらに需要を拡大することが見込まれます。当社におきましてはこれらをふまえ、生産能力の一層の増強をはかることといたしました。

これらにより、既に着手している設備投資分を含め、投資額は540億円（2018～2021年度計）となる見込みです。

### 【設備投資の概要（予定）】

- (1) 設備の内容 : 次世代フリップチップタイプパッケージ製造設備
- (2) 投資額 : 2018～2021年度投資額計 540億円  
本設備投資に必要な資金は自己資金、借入等をもって充当する方針です。
- (3) 設置工場 : 高丘工場（長野県中野市）他
- (4) 稼働開始予定 : 2020年度より順次稼働開始
- (5) 生産能力 : 本設備投資により、フリップチップタイプパッケージの生産能力は、既に着手している設備投資による寄与分を含め、約40%程度増強することを見込んでおります。



高丘工場（長野県中野市）

※ 本設備投資の稼働は、2020年度より順次開始することを予定しているため、本設備投資計画による2020年3月期連結業績に与える影響につきましては軽微であります。  
なお、今後開示が必要な事項が発生した場合は、適時開示を行う予定です。